

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-064

华海清科股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发行费用 154,365,956.02 元后，实际募集资金净额为 3,489,905,265.98 元。以上募集资金已于 2022 年 6 月 1 日到位，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 6 月 1 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	364,427.12
其中：超募资金金额	264,427.12
减：直接支付发行费用	15,436.60
二、募集资金净额	348,990.53
减：	
以前年度已使用金额	114,564.90
本年度使用金额	2,202.18
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	2.64
其他-永久补充流动资金金额	222,979.51
-超募资金回购股份金额	6,022.45
加：	
募集资金利息收入	2,993.24
其他-募集资金理财收益	9,279.59
三、报告期期末募集资金余额	15,491.67

上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年6月1日，公司分别与中国银行股份有限公司天津津南支行、国家开发银行天津市分行、天津银行股份有限公司长康支行、中国建设银行股份有限公司天津市分行和保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年2月，公司、华海清科（北京）科技有限公司（以下简称“华海清科北京”）分别与保荐机构及广发银行股份有限公司北京西三环支行、中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行、招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2022 年 6 月 1 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状态
华海清科股份有限公司	中国银行股份有限公司天津津南支行	271394878784	-	已注销
华海清科股份有限公司	中国建设银行股份有限公司天津津南支行	12050180080009688120	2,948.00	使用中
华海清科股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12000100000000000003	-	已注销
华海清科股份有限公司	天津银行股份有限公司长康支行	305001201090076644	-	已注销
华海清科（北京）科技有限公司	广发银行股份有限公司北京西三环支行	9550880238812800142	7,791.80	使用中
华海清科（北京）科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行	638220957	4,751.87	使用中
华海清科（北京）科技有限公司	招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行	122912514410802	-	已注销

注：1、鉴于公司募投项目“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”已结项，同时用于补充流动资金的募集资金已使用完毕，公司在国家开发银行天津市分行（账号：12000100000000000003）、天津银行股份有限公司长康支行（账号：305001201090076644）、中国银行股份有限公司天津津南支行（账号：271394878784）的募集资金专户已完成注销手续，注销时间分别为 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 12 日、2025 年 7 月 10 日。

2、鉴于华海清科北京于招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行存放的募集资金已使用完毕，华海清科（北京）在招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行（账号：122912514410802）的募集资金专户已完成注销手续，注销时间为 2023 年 12 月 28 日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026 年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026 年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。目前，“集成电路高端装备研发及产业化项目”已完成竣工备案手续，因项目整体竣工决算工作尚在推进中，相关财务核算与审计流程尚未完成；同时结合公司技术研发与产线升级的实际需求，项目配套设备的选型、采购及验收等工作仍在有序开展。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年半年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 6 月 1 日										
本年度投入募集资金总额			2,202.18										
已累计投入募集资金总额			344,789.52										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金 投向	募投项目性质	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
高端半导体装备（化学机 械抛光机）产业化项目	生产建设	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	13,937.42	-21,062.58	39.82 （注 1）	2022 年	不适用 （注 2）	不适用	否
高端半导体装备研发项目	研发项目	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	100.00	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
晶圆再生项目	生产建设	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	14,020.49	-979.51	93.47 （注 3）	2023 年 7 月	不适用 （注 4）	不适用	否
集成电路高端装备研发及 产业化项目	生产建设	无	0	50,000.00	50,000.00	2,202.18	38,660.57	-11,339.43	77.32	2026 年 12 月（注 5）	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,148.59	148.59	100.50 （注 6）	不适用	不适用	不适用	否
2023 年超募资金补充流	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

注 1：“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”已结项，该募投项目结项后节余募集资金为 21,300.44 万元，将投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”。

注 2：“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”的建设内容即公司“天津生产基地（一期）”，因公司以自有资金投入对天津生产基地进行了扩建及升级改造，并于 2025 年中投入使用，导致该项目 2025 年度及后续收益完成情况无法单独核算。

注 3：“晶圆再生项目”已结项，该募投项目结项后节余资金 979.51 万元，已用于永久补充流动资金。

注 4：“晶圆再生项目”设计建成后具备月加工 10 万片 12 英寸再生晶圆的生产能力，因晶圆再生业务市场需求及订单量持续快速增长，原设计产能已无法满足客户需求，公司自 2024 年起持续以自有资金投入“晶圆再生项目”进行产线扩张，并于 2025 年中达到月加工 20 万片 12 英寸再生晶圆的生产能力，且基本满产，导致该项目 2025 年度及后续收益完成情况无法单独核算。

注 5：2026 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审慎分析，同意将“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月。

注 6：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募投资金产生的利息。

注 7：募集资金计划投资总额超过扣除发行费用募集资金净额，一方面是“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”节余资金投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”，另一方面是超募资金产生的部分利息用于补流及回购公司股票。